

実装フェスタ関西 2024 インパクトポスター賞

受賞:6件

おめでとうございます!

件数	発表番号	タイトル	所属	発表者	共著者
1	P14	ナノポーラスCuめっき構造を用いた直接接合技術の提案	三菱マテリアル株式会社	中川 卓真 殿	古山 大貴 殿、片瀬 琢磨 殿、中川 将 殿
2	P10	半導体後工程向け低誘電材料を用いた高集積配線基板技術	荒川化学工業株式会社	山口 貴史 殿	
3	P39	2周波ICPを用いた Small TSV Etching技術の開発	株式会社アルバック	鈴木 大地 殿	
4	P38	ハイブリッド接合によるDRAMチップ積層に向けたセルフアセンブリ技術の基礎検討	東北大学大学院	福島 誉史 殿	杜 澤華 殿
			ヤマハロボティクスホールディングス株式会社	-	菱沼 隼 殿、菊地 広 殿
5	P6	金属塩の生成・分解反応を用いた各種金属材料の低温固相接合	群馬大学	小山 真司 殿	
6	P1	高分散性を有する低温焼結銅微粒子	花王株式会社	鈴木 佑京 殿	江山 誉昭 殿、中西 亮 殿、福田 泰紀 殿、稲家 修一 殿、武居 正史 殿

記念品:クリスタル置時計

